

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **PLP062725A-10F / Halogen free**

JEITA Package name; **P-UPLP010-02.50x02.70-0.50**

Lead frame plating; **Lead(Pb) Free**

Weight; **0.008 [g] ※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content *Note2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	0.40	シリコン	7440-21-3	0.85	999914	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.0000008	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.000002	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.000008	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.000004	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.0000008	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.000008	20	配線材
			タングステン ※3	7440-33-7	0.00001	30	配線材
パッケージ	ダイアタッチ材	0.05	コバルト ※3	7440-48-4	0.0000008	2	配線材
			銀	7440-22-4	0.04	770000	主成分
			エポキシ樹脂	-	0.01	200000	接着剤
	リードフレーム	1.95	フェノール樹脂	-	0.002	30000	接着剤
			金	7440-57-5	0.006	3000	主成分
			ニッケル	7440-02-0	1.86	954000	主成分
			銀	7440-22-4	0.08	43000	主成分
	ボンディングワイヤー	0.09	金	7440-57-5	0.09	1000000	主成分
	モールド樹脂	5.52	エポキシ樹脂	-	0.40	73000	主成分
			フェノール樹脂	-	0.19	34000	主成分
			シリカ	60676-86-0/-	4.68	849000	充填材
			有機リン化合物	-	0.03	5000	硬化促進剤
			カーボンブラック	1333-86-4	0.03	5000	着色剤
			金属水酸化物	-	0.19	34000	難燃剤

化学物質の情報について

※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。

※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。

従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。

※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。